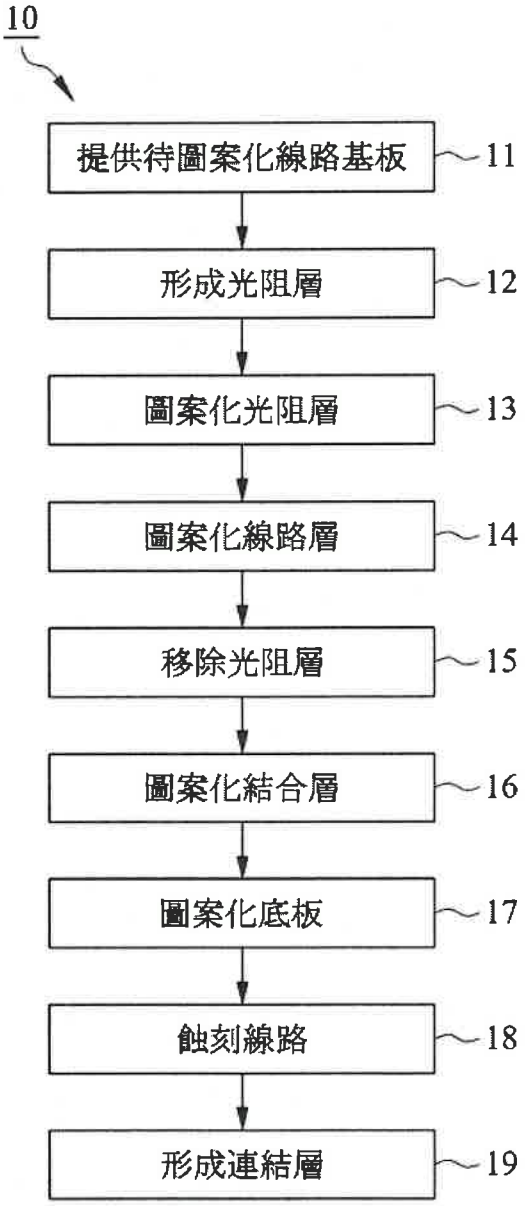
109 年度行專訴字第 38 號行政判決附圖

附圖 1

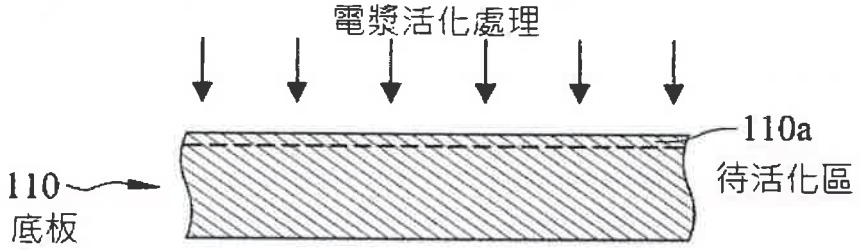
系爭專利主要圖式



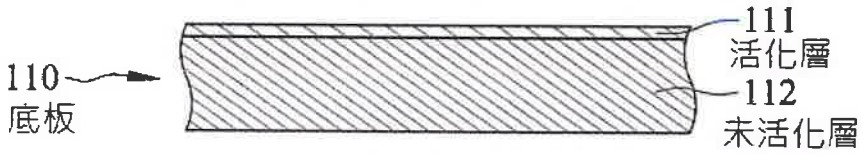
第 1 圖

圖 1 為第 1 實施例之立體圖

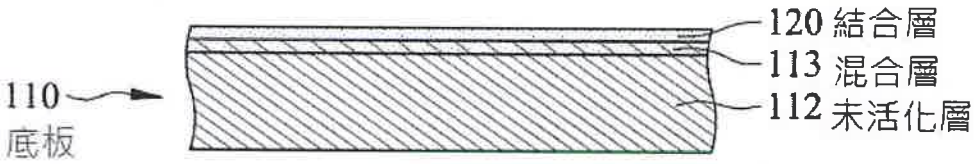
系爭專利第 1 圖為依據系爭專利之一實施例，一種線路基板圖案化製程之流程圖。



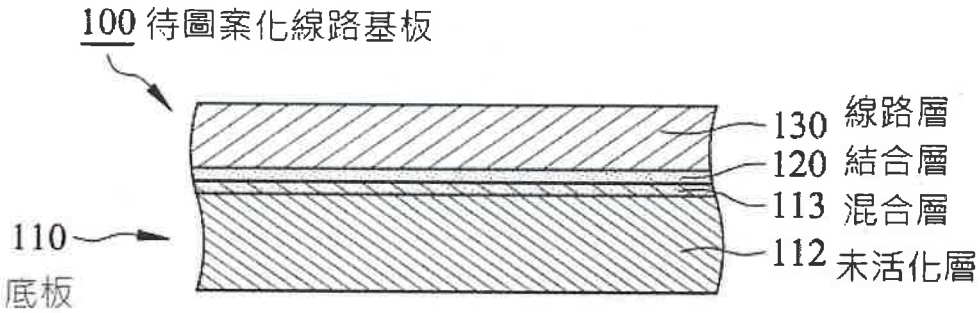
第 2 圖



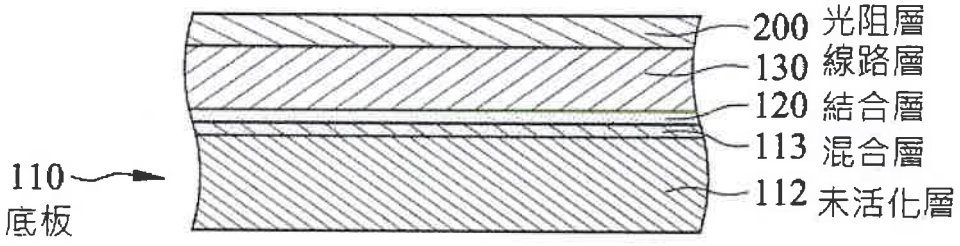
第 3 圖



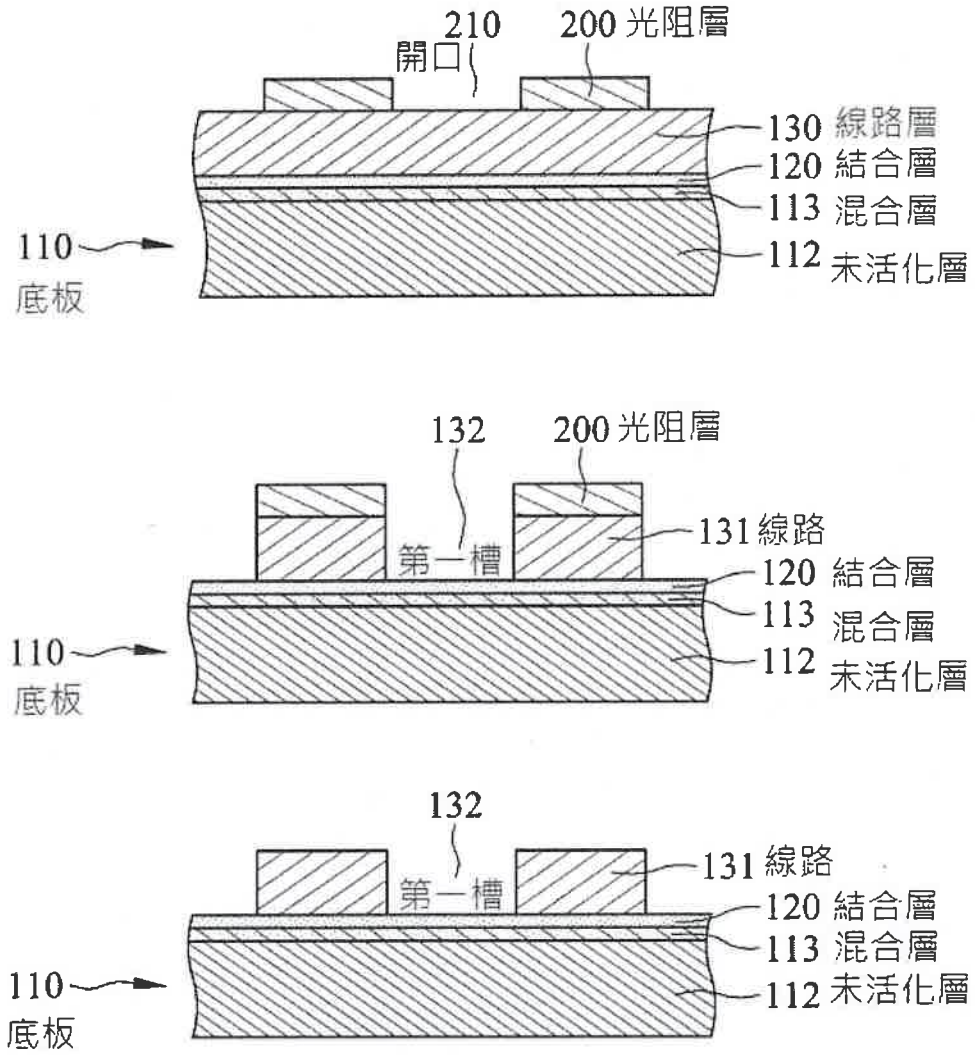
第 4 圖



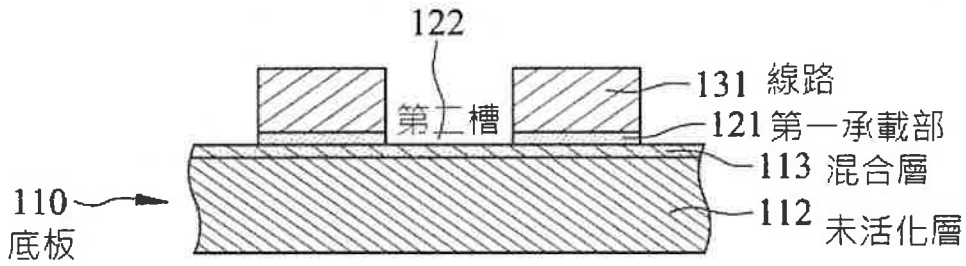
第 5 圖



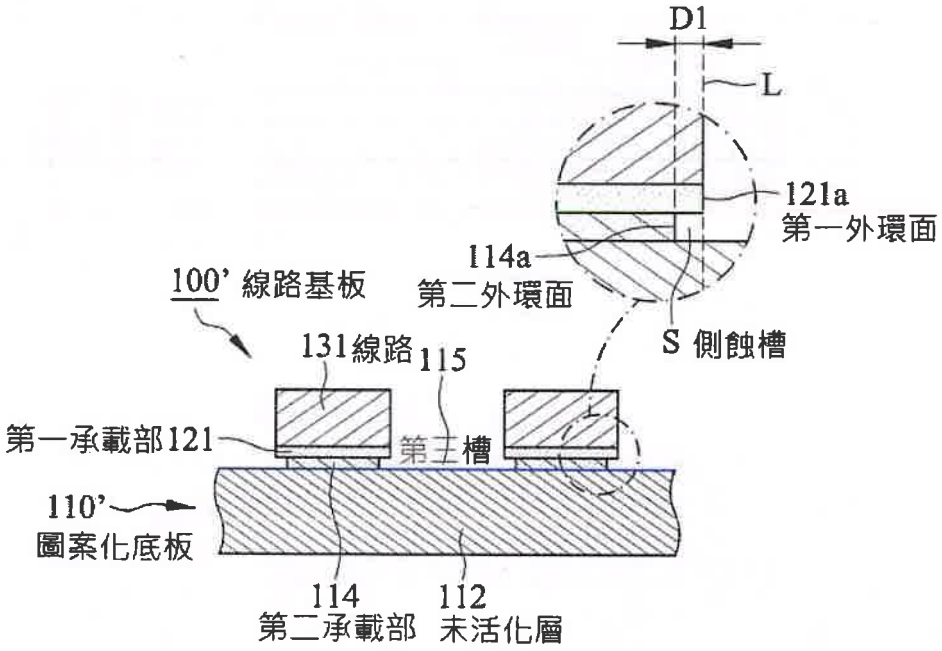
第 6 圖


210
開口
200 光阻層
130 線路層
120 結合層
113 混合層
112 未活化層
110
底板
132
200 光阻層
第一槽
131 線路
120 結合層
113 混合層
112 未活化層
110
底板
132
第一槽
131 線路
120 結合層
113 混合層
112 未活化層
110
底板

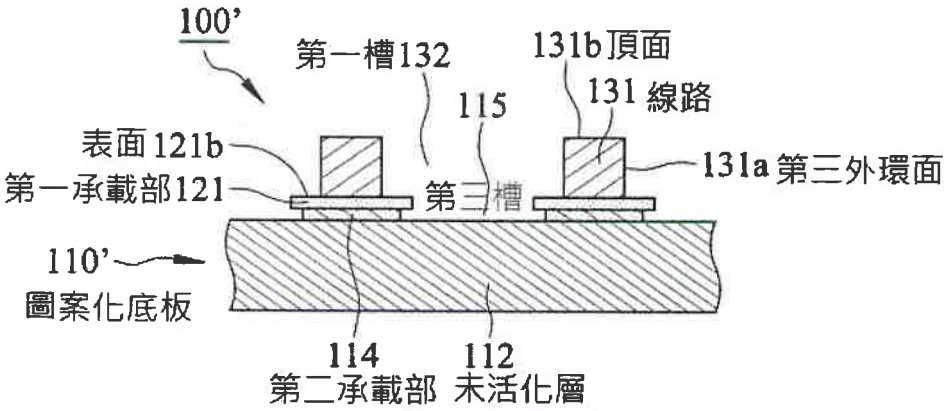
第 9 圖


122
第二槽
131 線路
121 第一承載部
113 混合層
112 未活化層
110
底板

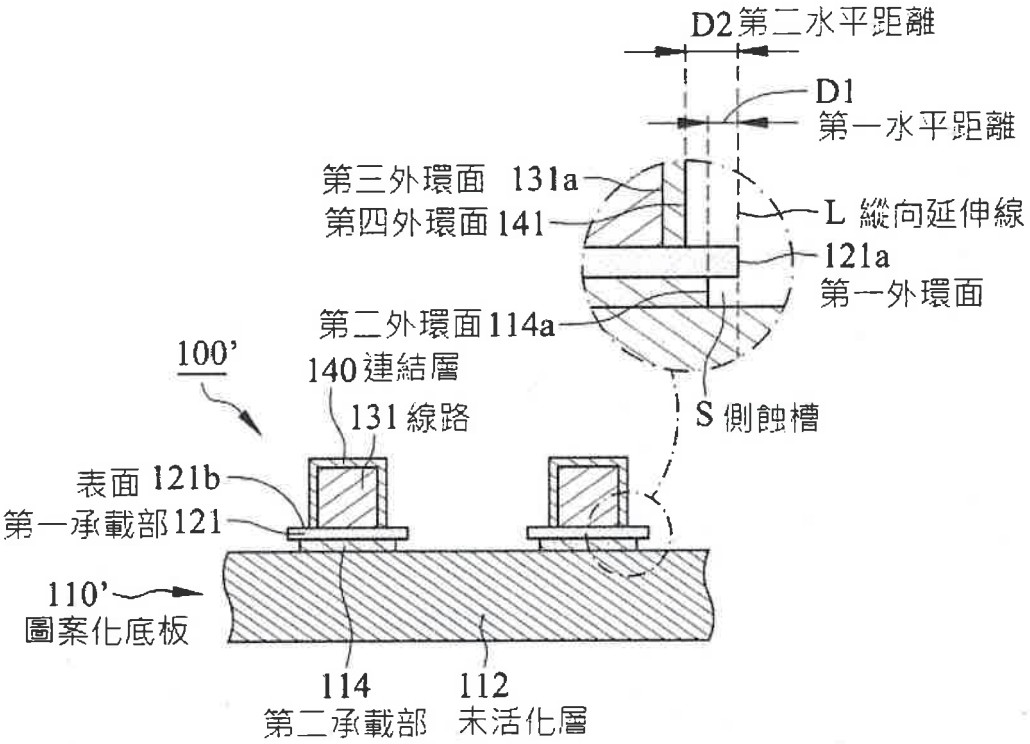
第 10 圖


D1
L
121a
第一外環面
114a
第二外環面
100' 線路基板
S 側蝕槽
131線路
115
第一承載部121
第三槽
110'
圖案化底板
114
第二承載部
112
未活化層

第 11 圖

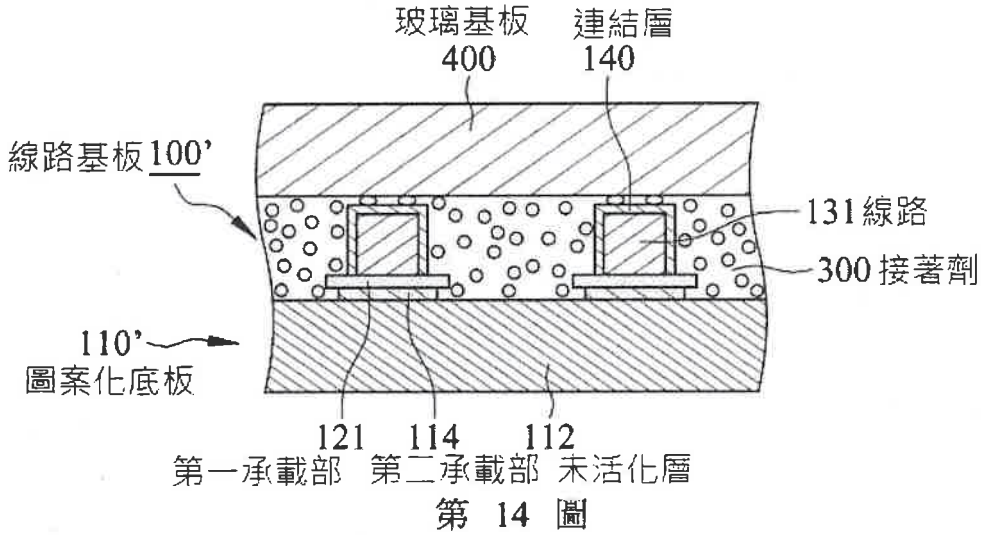

100'
第一槽132
131b頂面
131 線路
115
表面121b
131a第三外環面
第一承載部121
第三槽
110'
圖案化底板
114
第二承載部
112
未活化層

第 12 圖



第 13 圖

系爭專利第 2 至 13 圖為依據系爭專利之一實施例，一種線路基板圖案化製程之示意圖。



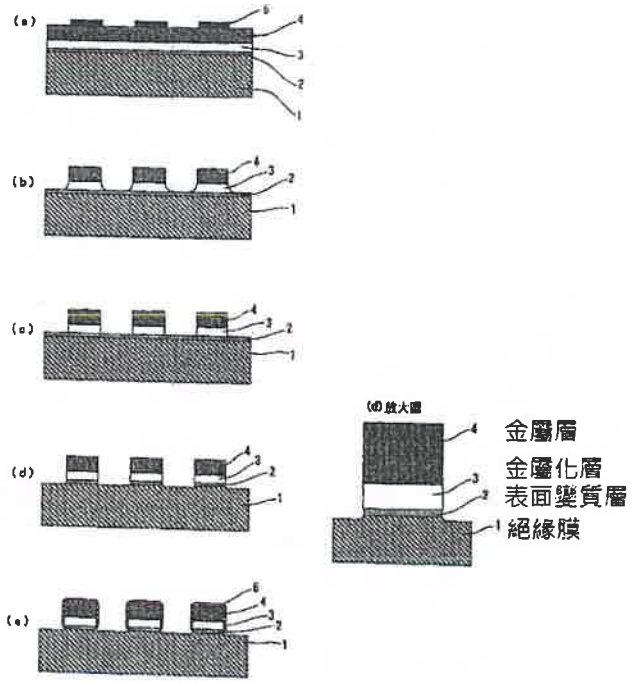
第 14 圖

系爭專利第 14 圖為依據系爭專利之一實施例，一種線路基板圖案化製程之示意圖。

附圖 2：

證據 1（我國第 I306367 號「軟性電路基板及其製造方法」專利案）

證據 1 主要圖式

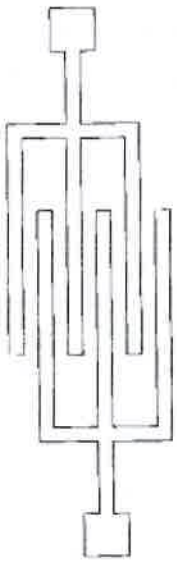


第 2 圖

附圖 3

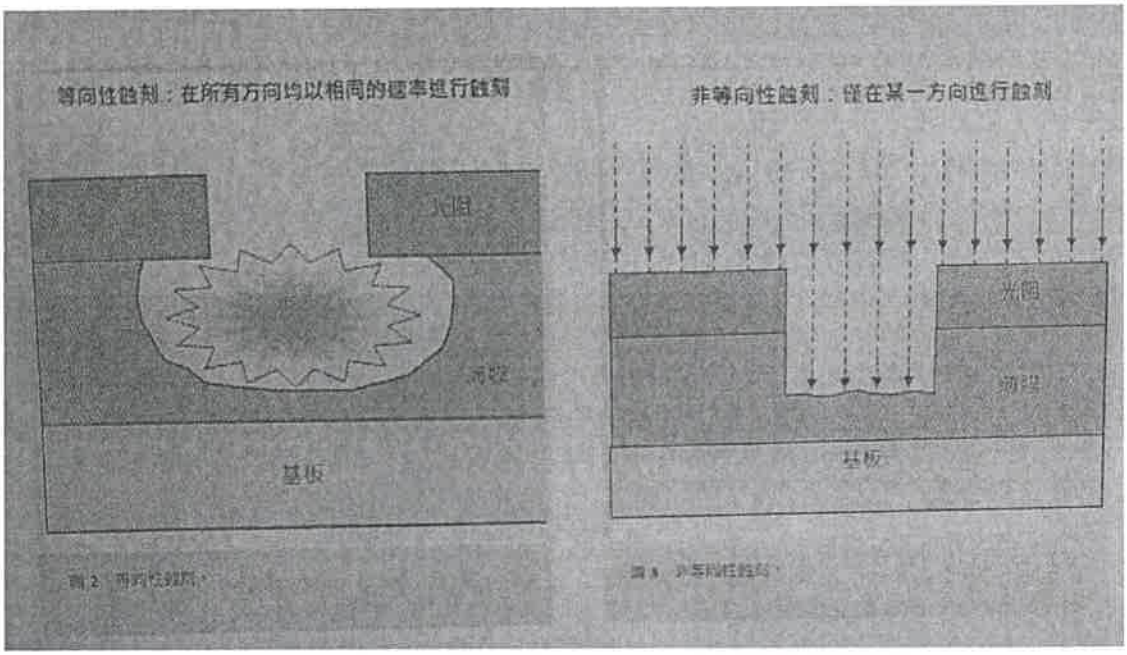
證據 2（日本特開 2003-188495 號「印刷配線基板的製造方法」發明專利案）

【図１】



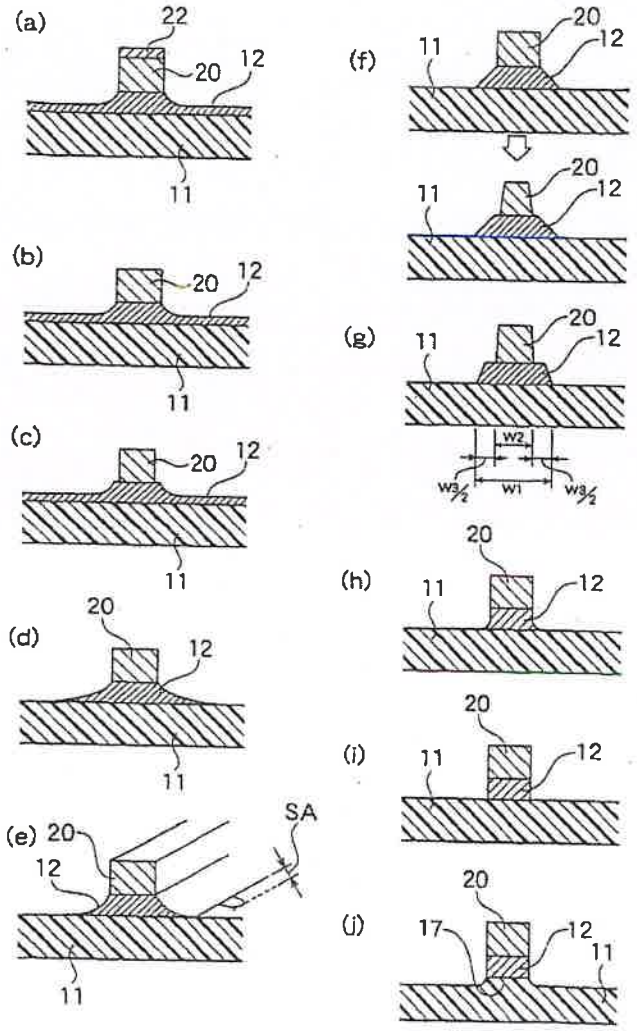
附圖 4

證據 3（朱俊霖著，「電漿與蝕刻」，奈米通訊季刊 2015 年第 22 卷第 4 期第 27 至 29 頁）

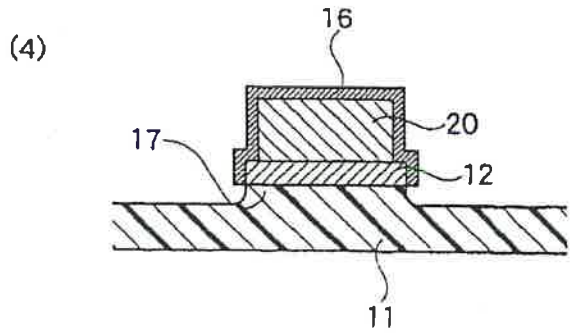


附圖 5

證據 4（我國第 I395531 號「印刷配線基板、其製造方法以及半導體裝置」專利案）



第2圖



第3圖

附圖 6

證據 5（中國大陸第 CN1819748B 號「蝕刻液和補給液以及使用它們的導體圖案的形成方法」發明專利案）

图 1

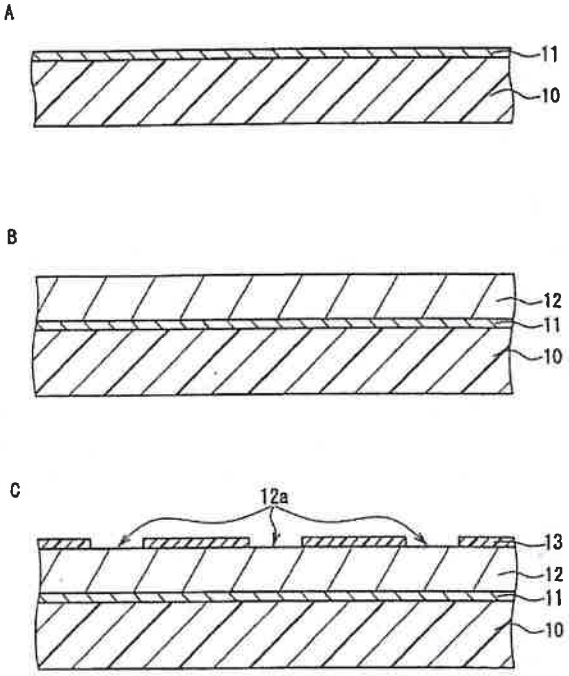
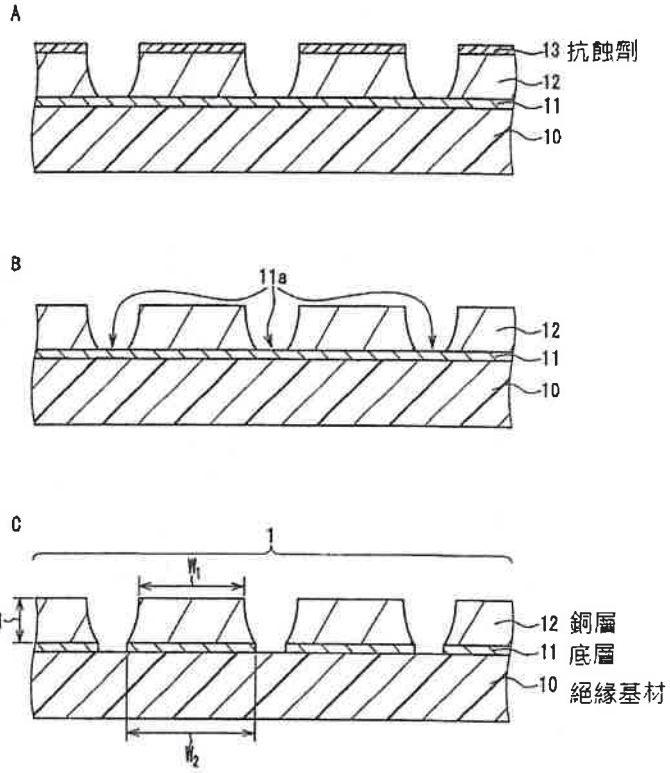
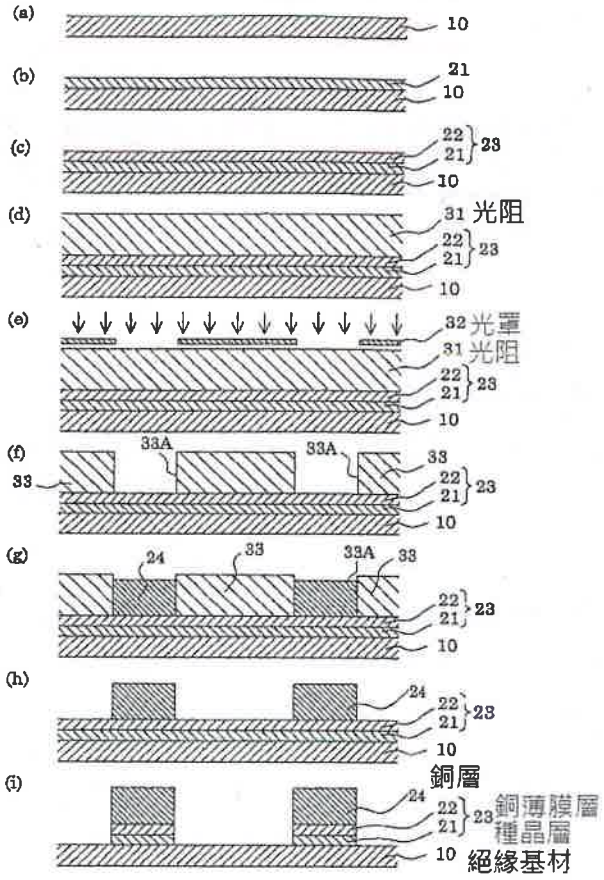


图 2



附圖 7

證據 6（我國第 TW201043111A1 號「半添加式電鍍法用硫酸系鍍銅液及印刷線路基板之製造方法」發明專利案）

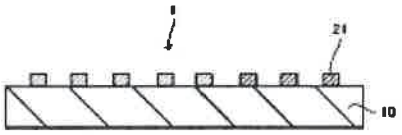


第 2 圖

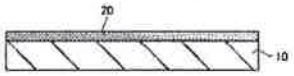
附圖 8

證據 7（日本特開 2013-67084 號「附金屬膜圖樣之基體的製造方法及模具的製造方法」發明專利案）

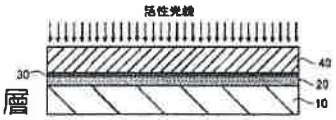
【図１】



【図３Ａ】

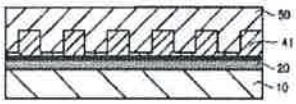


【図３Ｂ】

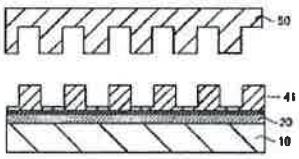


光反應性黏著層

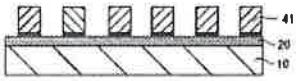
【図３Ｃ】



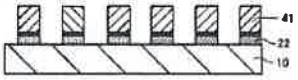
【図３Ｄ】



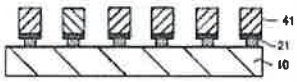
【図３Ｅ】



【図３Ｆ】



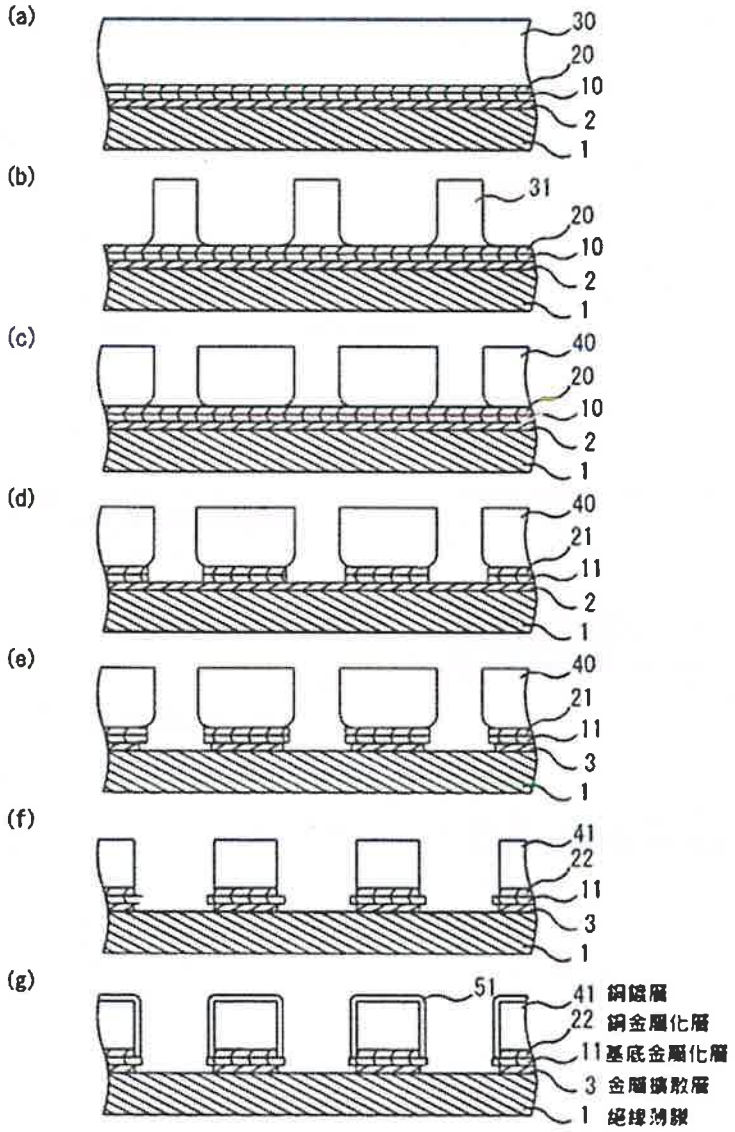
【図３Ｇ】



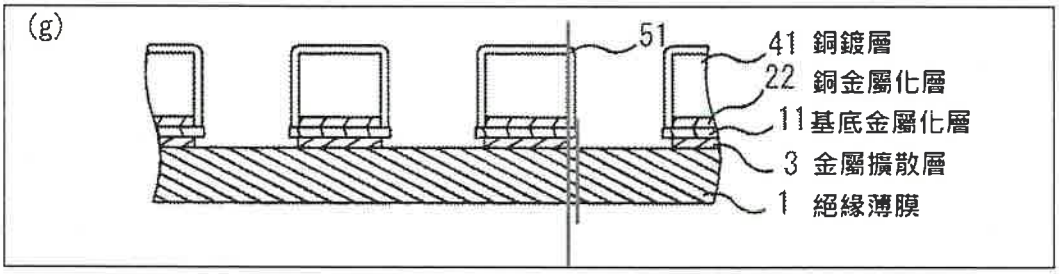
光阻膜圖樣
金屬膜圖樣
基體

附圖 9

證據 8（日本特許第 4720521 號「可撓性佈線基板及其製造方法」發明專利案）



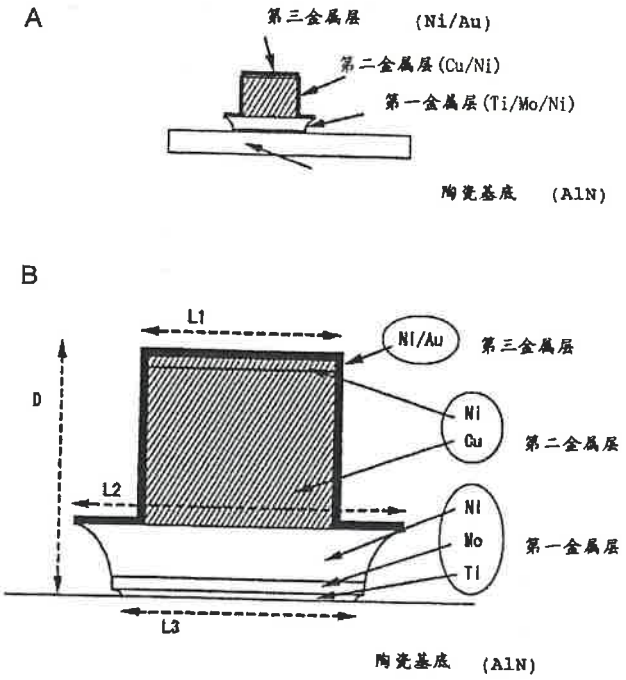
第 2 圖(g)放大

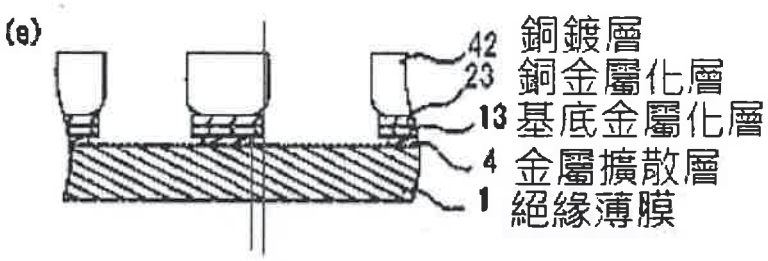


附圖 10

證據 9（中國大陸第 CN1412836A 號「電路板及其製作方法和高輸出模塊」發明專利案）

图 1





側蝕槽